# パルスレーザ光照射による金属表面への

# レインボーカラー加工

# Rainbow Color Processing to Metal Surface by Pulse Laser Light Irradiation

永田 伍雄<sup>\*</sup> Itsuo Nagata

キーワード:レーザ加工,干渉加工,虹色発色,回折格子,レインボーカラー,偽造防止

# 1. はじめに

レーザ光照射による金属表面への干渉色による着色 はステンレスやチタンを用いて行われている.ステン レスでは硝酸中でYAGレーザ光を照射し主に鉄の選 択的溶解によるステンレス板表面のNiとCrの組成比 を変えた後,酸化皮膜処理をして膜の干渉を利用した 干渉色のパターンを形成している<sup>1)</sup>.チタンでは陽極 電解中でレーザ光を照射し照射部での酸化膜の成長速 度をコントロールして干渉色のパターンを形成してい る<sup>2)</sup>.いずれも溶液中に置かれた金属板にレーザ光を 照射している.気体中では,モノシランガス中でステ ンレス板表面にレーザ光を照射することにより,シリ コンをドーピングし,表面の強度,耐食性を向上させ ると同時に,鋼の表面にできる薄膜を利用して干渉色 パターンを形成している<sup>3)~5)</sup>.

レインボーカラー加工は薄膜を作成して干渉色を発 生させるのではなく、2次元ホログラムと同じ回折格 子による干渉色で、金属表面に直接レーザ光で回折格 子を加工可能にした<sup>6)~8)</sup>.金属表面に空気中で単一レ ーザビームを照射し、照射レーザ光の発振波長1.06 μ mのYAGレーザ光と同等の間隔である1 mm あたり約 1000本の溝(回折格子)を照射スポット内に微細構造 として形成できる.レインボーカラーレーザ加工はC ADで作成したパターンまたはイメージスキャナで取 り込んだパターンを金属製品表面に虹色発色パターン として描画でき、しかも発色の方向を決定する溝の方 向をも自由にコントロールできる全く新しいレーザ光 の干渉現象を利用した加工手法である.

# 2. レインボーカラー加工

レインボーカラー加工はレインボーカラー発色を作 り出す回折格子の溝を,集光したレーザ光で等間隔に ー本一本加工するのではなく,単一ビームのシングル モードパルスレーザ光を空気中で金属表面に照射し, 照射スポット内に使用した照射レーザ光の波長と同じ 間隔の回折格子を形成する.加工材料として研磨ステ ンレス鋼板 (SUS304)を使用した.

レーザ光源として直線偏光のシングルモード超音波 Qスイッチ Nd:YAGレーザ光を使用して単一パルス レーザ光を照射してもステンレス鋼板への回折格子形 成は不可能である.しかし,照射レーザ光の集光をは ずして,ステンレス鋼板表面反射率が単一パルス照射 で少し変化が起こる程度の約 12MW~37MW/cm<sup>2</sup>のエネル ギー密度の光を複数回同一場所に照射すると,照射ス ポット内に回折格子が形成される.12MW/cm<sup>2</sup>のエネル ギー密度のパルスレーザ光を 120 回ステンレス鋼板に 照射すると、図1に示すように結晶粒単位で回折格子 が形成される.18WW/cm<sup>2</sup>のエネルギー密度のパルスレ ーザ光を34回ステンレス鋼板に照射すると、照射スポ ット内に回折格子が形成され始め、88回の照射で図2 に示すような照射スポット中心部に一様に回折格子が 形成される.図3は回折格子のSEM写真で、図4はS EM測定による断面形状である.溝間隔は使用波長と同 じ約1µmで、その溝の深さは約0.04µmである.最適 照射回数をオーバーしたレーザ光の照射は形成した回 折格子の溝を消失させ、一度消失した場所に再度、回折 格子は形成出来ない.

形成された回折格子の溝方向は照射レーザ光の偏光 方向に直交し,回折格子を構成する各々の溝の方向は, ほぼ同一である.回折格子形成時の照射レーザパルス光 の繰り返し速さは回折格子形成の良否に影響を及ぼさ ない.レーザ光照射ごとのステンレス鋼表面の観察か ら,初期のパルスレーザ光照射で結晶粒界腐食が起こ



図1 結晶粒単位の回折格子形成



図2 均一な回折格子形成



図3 回折格子のSEM写真



図4 SEM測定による断面形状

り,次に表面着色した後,回折格子が形成される.ス テンレス鋼表面が着色した初期の時点では,引き続き照 射されるレーザ光の任意の偏光方向に直交した方向の 回折格子が形成できる.

パルスレーザ光を繰り返し照射しながら一定スピー ドでレーザ光を移動させると,回折格子の溝を移動方向 に延長できる.既に形成された溝を消失させないで,溝 間隔の規則性を保ちながら,図5に示すように回折格子 が延長される非常に特異な現象がおこる.レーザ光を移 動しながら回折格子を形成する時,移動方向に対して形 成される溝方向が垂直の方が平行の溝形成より溝の規 則性を保って延長することができる.連続して回折格子



図5 レーザ光走査して形成した回折格子

を形成する時の最適移動スピードから単位面積あたり の照射回数を計算すると,停止時に比べて4割程度少な い照射回数で回折格子が形成できる.これは形成された 溝集団周辺部の照射レーザ光のエネルギーが初期のス テンレス鋼の着色に寄与しているためと思われる.

回折格子の溝はレーザ光の移動途中で移動方向を変 えても溝の方向にかかわらず延長できる.レーザ光の偏 光方向を出力損失なく任意の方向に変えるため図6に示 すように直線偏光のレーザ光を,1枚目の1/4波長板に より円偏光のレーザ光に変換し,2枚目の1/4波長板で 円偏光を直線偏光のレーザ光に変換する.2枚目の1/4 波長板を回転させて,目的の方向の直線偏光が設定でき るため,偏光面に直行してできる溝の方向も自由に制御 できる.図7に示すようにレーザビーム移動中,照射レ ーザ光の偏光方向を回転させると溝の方向はレーザ光 の偏光面の回転に対応して形成される.レーザ光の偏光 面を早く変更すると回折格子の溝がとぎれて形成され るが,約0.5mm進む間に90°程度の溝方向転換であれば 追従して形成できる.



図6 レーザ光の直線偏光方向回転光学系



図7 レーザ光の偏光面回転させ形成した回折格子 レーザ光を複数回照射して回折格子を形成する時,初 期の照射パルスレーザ光はステンレス鋼表面の酸化皮 膜形成に寄与していると思われる<sup>9)</sup>. 電気炉加熱を用い てステンレス鋼を空気中で 520℃, 30 分間の熱処理をす

ると金色の酸化皮膜層が形成できる.酸化皮膜の厚さは 偏光解析の測定から 0.018 µm である. ただし、未処理 のステンレス鋼表面に存在する酸化皮膜層の厚さは0と して,形成された酸化皮膜層の消衰係数は膜厚が薄いた め0として計算すると、未処理のステンレス鋼の屈折率 2.3 (0.6328 µm に於いて)が520℃の熱処理後3.2 に上 昇する.熱処理により元の金属の屈折率より高い屈折率 の薄膜が金属表面に形成されたため、干渉により金色に 着色している.熱処理をしたサンプルで回折格子形成を 試みたところ、熱処理をしなかったサンプルに比べて回 折格子の形成に必要なレーザパルス光の照射回数が半 減する.したがって、レーザ光移動時、最適溝形成スピ ードは処理無しに比べてほぼ2倍である.初期のレーザ 光の照射エネルギーはステンレス鋼板の表面の着色(酸 化皮膜形成)のみに消費される,回折格子は空気中,酸 素ガス中即ち酸素雰囲気中でのみ形成可能で,真空中や アルゴンガス中および窒素ガス中で溝は形成できない. レーザ光照射により形成した SUS304 (18Cr-8Ni)の表 面を 10 分間アルゴンガスでエッチングした場所の成 分は0:58.08, Fe:11.15, Mn:4.07, Cr:24.79, Ni: 1.91%でステンレス表面の Cr が多くなっている<sup>9)</sup>.

#### 3. 回折格子形成<sup>10)~12)</sup>

レーザ光が金属表面に垂直に照射されたとき,加工 金属表面に波長と同じ間隔の溝が形成されるためには, 金属表面が波長と同じ間隔でストライプ状に急速加熱, 急速冷却される必要がある.波長 $\lambda$ のレーザ光が加工 対象物に対して垂直に照射される場合,干渉縞の間隔 は $\Delta x = \lambda \sin \theta$  で与えられ,  $\theta$ は最大 90° であるか ら $\Delta x = \lambda と$ なる.したがって,波長と同じ間隔の干 渉縞を形成するためには,金属表面に垂直にレーザ光 が照射されたとき,図8に示すようにもう一方のレー ザ光は金属表面に平行に照射される必要がある.加工 サンプルに垂直に照射されたパルスレーザ光によって 形成された酸化皮膜(図9-1)を導波路として進むレ ーザ光が平行に照射されるレーザ光の役割をなす.導 波路は偏光解析の測定から0.018 $\mu$ m と波長に比較して 薄いため導波路光は導波路からにじみ出した状態で進



図8 レーザ光の交差角度

むと思われる.また,導波路が薄いため光が導波路へ進入するとき光の偏光方向による特性が現れ,垂直方向の 偏光面のレーザ光だけが進入可能なためレーザ光の偏 光面に対して垂直の溝が形成される.導波路へは初期の パルスレーザ光照射により形成された結晶粒界または 表面の凹凸(図 9-2)からレーザ光が進入し,照射レ ーザと干渉して,干渉パターン状にステンレス表面を 溶融する(図 9-3).レーザ光を移動させながら回折格 子形成を行う場合(図 9-4),照射パルスレーザスポッ トの前半の部分で酸化皮膜が形成され,後半の部分で 溝が形成される.既に形成された回折格子が回折格子 結合器の役割をするため,レーザビームスポット後半 部分の光が効率よく前の導波路へ導かれる.したがっ



図9 ステンレス表面への単一YAGレーザビーム 繰り返し照射による回折格子形成

て、回折格子結合器が導波路への光の位相関係を保つ ため、溝の間隔を一定に保った加工が可能になると考 えられ、実際の加工でも、レーザビームを止めて照射 したときより、移動しながらレーザ光を照射したとき の方が良好な回折格子が形成できる<sup>10011</sup>.図10にCA Dで描かれたパターンをステンレス製品表面に描画し た加工例を示す.





 図10 ステンレス板および市販スプーンの緩やかに カーブしている柄へのレインボーカラー加工
(加工品は見る角度および照明の方向を変えると虹の ように違った発色になる.カラー写真はレーザー研究
"目で見るレーザー最新技術"<sup>13)</sup>または研究所のホー ムページに掲載されているテクニカルシート 98004 を 参照してください)

### 4. 回折格子形成可能材料

レインボーレーザ加工は1 µm 間隔の溝を形成する 超微細な加工であるにもかかわらず,加工テーブルを 除振する必要がない.形成される回折格子の品質を問 わなければ加工物に1mm 程度の長周期の凹凸があって も加工できる特長を持っている.ただし,短周期(1 μm)の凹凸は加工品質を低下させる.加工可能な材料 は主にステンレス鋼で,種類によりCr・Ni含有率が異 なるため,加工品質に違いが生じる.

合金だけでなくNiやCrにも回折格子が形成できる. たとえば、10µmの厚さのCrメッキ表面には形成可能 である.粉末冶金で形成されたCr板はCr粉末の凹凸 があるためか回折格子が形成できない.Niは照射エネ ルギー密度の範囲が狭いけれど回折格子形成が可能で ある.ステンレス鋼を構成する鉄には回折格子が形成 出来ない.プラスチックの射出成形用金型に用いられ る13.6%Crを含んだステンレス工具鋼は18-8ステン レス鋼のようにレーザパルス光照射初期にできる結晶 粒界腐食による金属表面の悪化がほとんど見られず, 良好な回折格子が形成可能で、プラスチック複製品の 金型として利用可能である.その他今までに見いだし た回折格子形成可能材料について下記に示す.

#### (1) モリブデン<sup>14)</sup>

表面を洗浄した Mo は回折格子が形成できない. さら に、ステンレス鋼は加熱処理で形成した酸化皮膜を持 つ材料にも良好な回折格子が形成できるが、Mo はレー ザ光照射で酸化皮膜のみが除去され回折格子は形成で きない.しかし、表面に油の付着した Mo では図 11 に 示すような回折格子が形成できる.レーザパルス光照 射で表面に付着した油成分の硫黄と Mo が反応して MoS<sub>2</sub> ができ、この膜がステンレスの酸化皮膜と同等の役目 をするものと思われる.しかし、ステンレスのような 良好な回折格子は形成できない.



図 11 油の付着したモリブデンへの回折格子形成 (2) ニッケルーリン合金メッキ<sup>15)</sup>

ニッケルに比べて表面硬度が2倍で、様々な金属にメ ッキ可能なニッケルーリン合金メッキ層はあらかじめ 加熱処理を行うと回折格子が形成可能である.しかし、 加熱処理をしていないニッケルーリン合金メッキ層は

ニッケルメッキでは可能なレーザ光照射初期段階で形 成される酸化皮膜層が形成されない. したがって、光 干渉加工の基本となる導波路が形成できず、ニッケル ーリン合金表面に虹色発色源の凹凸(回折格子)が形 成できない、しかし、たとえばアルミニウム板表面に ニッケルーリン合金が約10µm厚無電解メッキされた サンプル (コンピューターのハードディスク基板) を 350℃の電気炉で空気中熱処理したサンプルは熱処理 によりメッキ層表面に表面状態の良い酸化皮膜が形成 される.酸化皮膜は下地金属と屈折率が異なるため、 加熱時間とともに厚さが増加し、膜による干渉色を示 す. 金色から膜が厚い紫色を示す状態でも、金属表面 に粒界腐食等から成長するひび割れ等がなく非常に綺 麗な表面状態である.干渉色は表面状態が良好なため 鮮やかである. ESCA の分析結果から、Ni-P メッキの熱 処理無しサンプルの Ni は Ni (metal) + Ni<sub>2</sub>0<sub>3</sub>でサンプ ル表面からはPが検出された.熱処理するとNi0+Ni,0。 になり、メッキ表面層から P が無くなり NiO が増加し た.15分加熱(金色)で2.4~3.6nm付近から、2時 間加熱(紫色)で3.6~4.8nm付近からPが検出された. Ni-P 合金メッキ層は空気中加熱処理により P が無くな るため、レーザ光照射により良好な回折格子が作成さ れる.パルスレーザ光照射のような短時間の加熱では Pをメッキ金属表面から取り除くことができないよう である.回折格子の加工性は熱処理時間が長いほど向 上する. 青から紫色を示すサンプルではステンレス材 料の最適加工条件より約10倍のスピードでレーザビ ームを走査しても図12に示すように良好な回折格子



図 12 ニッケルーリンメッキ層への回折格子形成 (加工周辺部)

が作成できる.

Ni-P 合金メッキは表面に直接,回折格子を形成する ことのできないアルミニウムをはじめ,様々な金属材 料にメッキ処理できる.熱処理時間をコントロールし て生成される酸化皮膜厚による干渉色を金色から紫ま で変化できる上に,図13に示すようにレーザ光照射に より回折格子が形成でき,従来にない2種類の干渉色 で金属表面を加飾できる特長がある.



図13 加熱処理ニッケルーリン合金メッキ層 (膜による干渉色有り) へのレインボーカラー加工

# 5. レインボーカラー加工の応用

レインボーカラー加工は金属表面の装飾以外にプリ ペイドカードやICカードに本微細加工技術を導入す れば、カード等の偽造防止に有効と思われる.本技術 はNHKの生中継放送(おはよう日本・おはよう関西) で偽造防止技術の一例として紹介してもらったように ホログラムと同様の視覚による偽造防止手段に加えて、 磁気記録の(N・S)制御と同様にデジタル情報をレ ーザ光により形成する回折格子の溝方向角度に変換し て記録し、読み出しレーザ光により回折される回折光 角度の違いとしてデジタル信号を読み出すことが出来 る.図14に示すように要望に応じて虹色のワンポイン トパターンおよび文字を入れることもできる.加工物 を金型としてプラスチックフイルムに熱転写が可能で、 電鋳すれば金属複製品の作製も可能である.図15に示 すようにホログラムカードに比べて少ない工程で虹色 情報記録カードが作成できる特長がある<sup>10)16)</sup>.



図 14 偽造防止プリペイドカードへの応用例



図 15 ホログラフィー技術と比較

#### (1)偽造防止カード

本手法は図7に示すように照射レーザ光の偏光方向 に対応して金属表面に形成される回折格子の方向をも 回転させて記録できる特性を利用する.図14にレイン ボーカラーレーザ加工を用いてプリペイドカード用金 型として使用可能な高硬度ステンレス鋼に加工した応 用例を示す.カード中心部にカード使用回数等の情報 が記録可能なレインボーゾーンを設け,使用度数ごと に穿孔するか,レーザ光で熱消去し再生不能に出来る. 偽造防止効果の増大のため,ホログラムでは作成が困 難な文字等の虹色発色パターンを要望に応じて付加で

きる.カード裏側には従来の磁気記録を残し、レイン ボー情報との照合を行えば、偽装防止効果のさらなる 向上が期待できる.デジタル情報は、間欠して溝方向 をコントロールする方法、連続して溝方向をコントロ ールする方法および両方法を切り替えながら記録でき る. レーザ加工可能な情報記録線幅は通常約 0.1~ 0.2mm であるが、照射レーザ光形状を変えて対応でき る.回折格子の溝の方向を連続して変更できる.もち ろん、レーザビームを走査しながら溝方向を 360°連 続して回転可能である.回転途中で回転方向を自由に 切り替えができ,他の加工方法では偽造が困難な加工 が簡単に出来る. 記録幅が狭く, また連続して溝が回 転しているためホログラム等の切り張りでは偽造が困 難である. レインボーカラーレーザ加工は特定条件下 でのみ加工可能である. 照射レーザ光の特性, 加工テ ーブル性能,加工金属表面状態等により,溝細部は指 紋のように異なったパターンを示し、偽造しにくいと 思われる.カードに厚さ 20µmのステンレス箔を貼る ことにより、直接レーザ光でカードごとに個別の情報 書き込みができ、さらに偽造防止効果が向上するため、 個人認識カードにも対応可能で、プリペイドカード以 外の高度なカードへの応用が可能である.

#### (2) 情報読みだし

(a)カードを移動させて磁気記録読み出しと同時 に、回折格子の溝情報を読み出す方法例を図16に示す. カードに記録された情報は半導体レーザ光をレインボ ーゾーンの回折格子に照射し、1次回折光が反射して くる位置に光センサーを置き、半導体レーザ光照射部 の溝方向を読みとる.カードの穿孔の有無は透過セン サーで読みとる.読み出しレーザ光を細い情報記録ラ イン上にコントロールして照射困難なときは読み出し レーザ光をシリンドリカルレンズでライン状に集光し、 情報記録ラインの位置変動に対応できる.

(b)カードを静止して溝情報を読み出す方法例を 図 17 に示す.カード周辺から,半導体レーザを照射し, 溝集団から回折される回折光を指紋照合装置のように CCDカメラを用いて画像処理し,虹色パターン内に 書き込まれた情報を読みだす.読み出しレーザ光を切 り替えて溝情報を読み出し可能なため,より複雑な偽 造防止効果が望める.指紋照合装置を流用すれば安価 な読み出し装置が製造可能と思われる.



図 16 偽造防止虹色情報読みとり方法構成図



図 17 CCDカメラを用いた偽造防止虹色情報読みと り方法構成図

## 6. おわりに

レインボーカラーレーザ加工は他の微細加工を行っ ていたとき偶然見つかった現象で,一般に行われてい

るレーザ光の光エネルギー利用に加えてレーザ光の干 渉性を利用した新しい加工技術を採用している. 通常 では考えられない加工現象を発展させて、簡単にCA Dを用いて作成したパターンを金属製品表面に虹色発 色パターンとして加工が可能である. 金属製品表面が 1mm程度うねっていても加工でき、オートフォーカス 機構を組み込めば、1mm以上の凹凸製品表面にも回折 格子形成が可能で、現在加工に用いているYAGレー ザ光と第2高調波用レーザ光の2波長を用いれば、溝 間隔の異なる回折格子が形成でき,幅広い回折角度が 得られるため、視認性が広がった発色パターンの加工 ができるとともに偽造防止カードにも威力を発揮する. 本加工は非常に特異な現象であるため,現状では Cr か Ni が関与する材料で良好な回折格子が形成できる. 今 後,Ni-Pのような金属表面に導波路となる薄膜が形成 可能な材料が見つかれば、さらなる発展が望める.

#### 参考文献

- 前田重義,山本正弘,小俣裕保:73回金属表面技 術協会予稿集,(1986),152
- 2) 前田重義:レーザー研究, 18-4, (1990), 289

- 8) 杉岡幸次,田代秀夫,豊田浩一:レーザー研究, 19-3 (1991),220
- Sugioka, K., Tashiro, H., Murakami, H., Takai, H. & Toyoda, K. : Jpn. J. Appl. Phys. 29-7, (1990), L-1185
- Sugioka, K., Tashiro, H., Toyoda, K., Tamura, E. & Nagasaka, K. : J. Mater. Res., 5-2(1990), 256
- 6) 永田伍雄,平田繁一:11 回レーザー学会予稿集, (1991),178
- 7) 永田伍雄,平田繁一:27 回レーザ熱加工研究会論 文集,(1991),177
- 8) 永田伍雄:応用機械工学, 4-386(1992),82
- 9) 永田伍雄:13回レーザー学会予稿集, (1993),169
- 10) 永田伍雄:161 回塑性加工シンポジウム, (1995), 29
- 11) 永田伍雄: 塑性と加工, 36-411(1995), 321
- 12) 永田伍雄:42 回レーザ熱加工研究会論文集, (1997),141
- 13) 永田伍雄:レーザー研究, 21-7, (1993), i
- 14) 永田伍雄:16回レーザー学会予稿集,(1996),155
- 15) 永田伍雄, 成願茂利, 榎本正敏:21 回レーザー学 会予稿集, (2001), 125
- 16) 永田伍雄: OPTRONICS, 5(2000), 179